

**KOMISJONI OTSUS,****21. oktoober 2005,****millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) lisa***(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4054 all)***(EMPs kohaldatav tekst)***(2005/747/EÜ)*

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavate sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlike ainete sisaldust.
- (2) Teatavate pliid ja kaadmiumi sisaldavate materjalide ja osade suhtes peaks kehtima [või edasi kehtima] erand kõnealusest keelust, kuna selle ohtliku aine kasutamine konkreetsetes materjalides ja osades on endiselt vältimatu.
- (3) Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide ja osade keelust peaksid kohaldamisala osas olema piiratud, et nii saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.
- (4) Direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktiga c on ette nähtud iga lisa nimetatud erandi läbivaatus iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse, mille eesmärk on kaaluda elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide väljajätmist lisast, kui kõrvaldamine või asendamine konstruktsiooni-muutuste või materjalide ja komponentidega, mis ei nõua

artikli 4 lõikes 1 nimetatud materjalide või ainete kasutamist, on tehniliselt või teaduslikult võimatu või kui asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele tekkiv kasu.

- (5) Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.
- (6) Komisjon on vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 konsulteerinud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide, töövõtjate ja tarbijaühingutega ning edastanud märkused nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ (jäätmete kohta) <sup>(2)</sup> artikli 18 alusel loodud komiteele.
- (7) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas komitee arvamusega,

ON VASTU VÖTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

*Artikkel 2*

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. oktoober 2005

*Komisjoni nimel  
komisjoni liige  
Stavros DIMAS*

<sup>(1)</sup> ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on muudetud komisjoni otsusega 2005/717/EÜ (ELT L 271, 15.10.2005, lk 48).

<sup>(2)</sup> EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

## LISA

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkt 7 asendatakse järgmisega:

- “7. — Plii kõrge sulamistemperatuuriga joodises (nt pliisulamid, mis sisaldavad pliid 85 % massist või üle selle),
- plii serverite, salvestiste ja salvestimaatriksite ning kommuteerimiseks, signaalimiseks, edastamiseks ettenähtud võrgu infrastruktuuri seadmete ja telekommunikatsioonivõrgu haldamisseadmete joodises,
  - plii elektroonilistes keraamilistes osades (nt piesoelektronilistes seadmetes).”

2. Punkt 8 asendatakse järgmisega:

- “8. Kaadmium ja selle ühendid elektrikontaktides ning kaadmiumiga katmine, välja arvatud direktiiviga 91/338/EMÜ (millega muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ (\*) ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piiramise kohta (\*\*)) keelatud otstarbel.

(\*) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.  
(\*\*) EÜT L 186, 12.7.1991, lk 59.”

3. Lisatud on järgmised punktid:

- “11. Plii pin-ühendus süsteemides.
12. Plii soojust juhtiva mooduli voluringi kattematerjalina.
13. Plii ja kaadmium optilises ja filterklaasis.
14. Plii üle kahe elemendi sisaldava joodise koostises pin ühenduskontaktide ja mikroprotsessorite pakkimiste vahel ühenduseks, kusjuures pliisisaldus on üle 80 % ja vähem kui 85 % segu kaalust.
15. Plii joodise koostises, millega luuakse elektriühendus pooljuhi viigu ja volukandja vahel integreeritud Flip Chip lülituste pakkimiste sees.”
-